103 めっき用電解隔膜 Electrolytic Diaphragm For Plating

添加剤の消耗を抑制し、めっき性能を向上させる電解隔膜

The electrolytic diaphragm controls the consumption of additives and enhances plating performance.



特長 Features

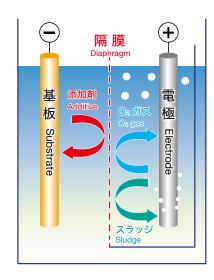
- 微細孔により、低電気抵抗かつ液体の移動が少ない中性膜 Being microporous, the neutral membrane involves low electric resistance and smaller movements of liquid.
- 優れた耐薬品性 Highly resistant to chemicals
- 使用前は乾燥状態で保存できるため、取扱いが簡単 It can be handled easily because it can be kept in dry conditions before use.
- スリット、袋状、フレーム溶着など様々な形状に加工が可能 It can be processed in many different forms such as slit, bag and frame welding.
- イオン交換膜に比べて安価 Less expensive than ion exchange membranes.

用途 Applications

電子部品工場 Electronic component plants

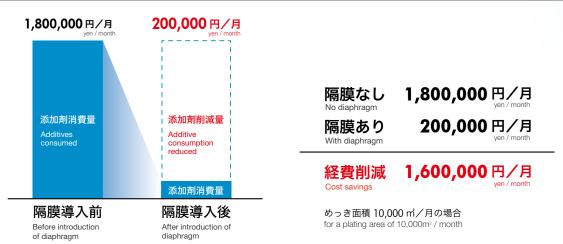
- 銅めっき用隔膜 (ビアフィル/スルーホールなどの微細な制御が必要なプリント基板用に特に有効) Diaphragm for copper plating (especially effective in printed circuit boards necessitating fine controls, such as via filling and through hole)
- ニッケルめっき用隔膜 Diaphragm for nickel plating
- あらゆる電気めつき用途 All applications of electric plating

効果 Effects





添加剤コスト比較(実施例) Comparison of cost for additive (examples)



型式 Model	材質 Material		厚さ ^{※1}	電気抵抗 ^{※2} Electricity	膜極性	ウォーター フローレート	保存	加工対応幅 ^{※3} Processing
	膜材 Membrane	基材 Base	Thickness *1 mm	resistance ['] *2 Ω · cm³	Membrane polarity	water flow rate	Storage	Width *3 mm
Y-9205TA	ポリフッ化ビニリデン 酸化チタン、ショ糖脂肪酸エステル Polyvinylidene fluoride Titanium oxide, Sucrose fatty acid ester	ポリエチレン テレフタレート Polyethylene Terephthalate	0.22 ± 0.03	≦ 0.90	中性 Neutral	≧ 10	乾燥保存可能 Can be stored in dry conditions	500
Y-9207TA			0.17 ± 0.04					750

- ※ 1 マイクロメーターによる *1 micrometer
- ※ 2 塩化ナトリウム水溶液 20wt% による *2 N ※ 3 長さ方向はご希望の寸法にカットいたします。 *2 NaCl aqueous solution 20et%
- *3 We will cut it desired legth.
- 記載値は代表値であり、保証値ではありません。 The information shown above are representative values and are not guaranteed.